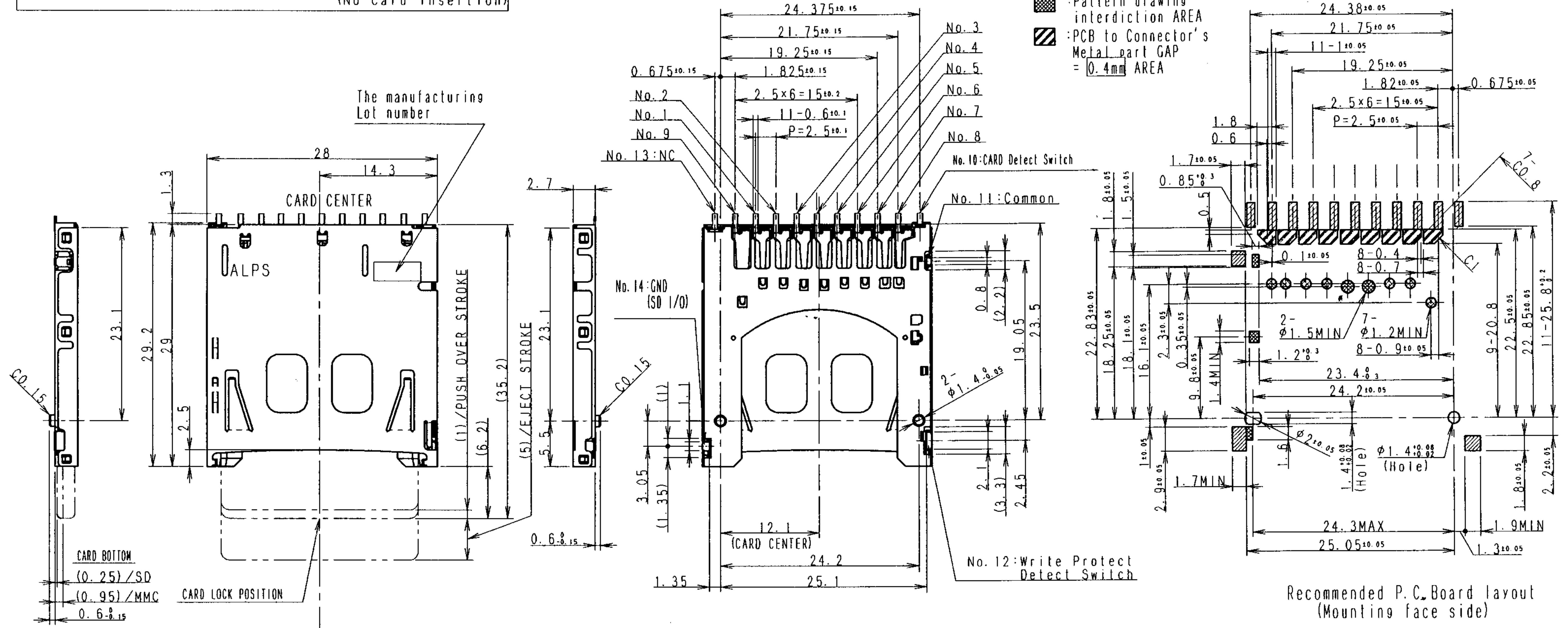


▨ : LAND AREA
▣ : Pattern drawing interdiction AREA
▧ : PCB to Connector's Metal part GAP = 0.4mm AREA



NOTE

1. This connector is standard (top) mount type.



The tolerances unless otherwise the spec

10 under	±0.3
ABOVE 10 TO 100	±0.5
ANGLE	±3°

ZONE	SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD
▲					
▲					
▲					
▲					
▲					

ALPS ELECTRIC CO., LTD.			
DSGD.	2002.12.26 D4G K. KATO	SCALE /	MODEL No. (製品番号) SCDA1A0901
CHKD.	2002.12.26 D4G Y. OKABE		TITLE PRODUCT DRAWING (製品図)
APPD.	2002.12.26 D4G T. WAGATSUMA	UNIT mm	DOCUMENT NO. SCDA1A0901. AE11.003

DOCUMENT No. SCDA-S-014	TITLE 製品仕様書 PRODUCT SPECIFICATION	PAGE 1/6
BACKGROUND SONNOK-1504		(標準)

1. 一般事項 GENERAL ITEMS

1.1 適用範囲 APPLICATION

この仕様書は主として電子機器に用いるSDメモリーカード用コネクタに適用する
THIS SPECIFICATION APPLIES TO THE SD MEMORY CARD CONNECTOR.

1.2 使用温度範囲 : -25 ~ 70 °C

OPERATING TEMPERATURE RANGE : -25 ~ 70 °C

1.3 保存温度範囲 : -25~85 °C

STORAGE TEMPERATURE RANGE : -25~85 °C

1.4 試験状態 TEST CONDITIONS

試験及び測定は特に規定がない限り以下の標準状態のもとで行う。

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, THE TESTS AND MEASUREMENTS ARE TO BE CARRIED OUT IN THE FOLLOWING STANDARD CONDITIONS.

温度 (TEMPERATURE) : 5~35 °C
 相対湿度 (RELATIVE HUMIDITY) : 25~85 %
 気圧 (AIR PRESSURE) : 86~106 kPa

ただし、判定に疑義を生じた場合は以下の標準状態で行う。

HOWEVER, IF DOUBTS ARISE CONCERNING JUDGMENTS, PERFORM UNDER THE FOLLOWING STANDARD CONDITIONS.

温度 (TEMPERATURE) : 20±2 °C
 相対湿度 (RELATIVE HUMIDITY) : 80~70 %
 気圧 (AIR PRESSURE) : 86~106 kPa

2. 外観、構造、寸法、 APPEARANCE, CONSTRUCTION AND DIMENSION

2.1 外観 APPEARANCE

各部の仕上げは良好で、機械上有害な錆、傷、割れ、メッキ不良及び剥離等があってはならない。

EACH AREA MUST BE FINISHED WELL AND THERE MUST BE NOT RUST, SCRATCHES, CRACKS AND INFERIOR OR PEELING PLATING, etc. THAT MAY PROVE HARMFUL IN TERMS OF PRODUCT FUNCTIONING.

2.2 構造、寸法 CONSTRUCTION AND DIMENSIONS

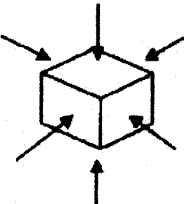
個別製品図による。

SEE THE SEPARATE PRODUCT DRAWING.

3. 定格 RATING

DC 3.6 V/0.5 A 1ピンあたり (PER PIN)

																APPD.	CHKD.	DSGD.
																Oct.25.2002	Oct.25.2002	Oct.25.2002
																T.Waga@stamu	Y.Okabe	A.Uchiyama
PAGE	SYMB	BACKGROUND	DATE	APPD	CHKD	DSGD	PAGE	SYMB	BACKGROUND	DATE	APPD	CHKD	DSGD					

DOCUMENT No. SCDA-S-014	TITLE 製品仕様書 PRODUCT SPECIFICATION		PAGE 2/6
BACKGROUND SOKNIK-1504			
4. 初期特性 INITIAL CHARACTERISTICS			
4.1 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS			
	項目 ITEM	試験条件 TEST CONDITIONS	判定基準 CRITERION
4.1.1	接触抵抗 CONTACT RESISTANCE	測定に関しては端子の半田付け部までの導体抵抗を含むものとする。 WITH REGARD TO MEASUREMENT, CONDUCTOR RESISTANCE DOWN TO THE SOLDERED PARTS OF THE TERMINALS ARE INCLUDED. ダミーカード(プリント基板)を嵌合した状態で 開放電圧: 20mV 以下 測定電流: 1mA WITH DUMMY CARD (PCB) ATTACHED. APPLY 1mA, 20mV MAXIMUM	3PP接触点 100 mΩ 以下 (初期値) 140 mΩ 以下 (試験後) 検出スイッチ接点 100 mΩ 以下 (初期値) 140 mΩ 以下 (試験後) CONNECTOR CONTACTS 100 mΩ Max. (INITIAL VALUE) 140 mΩ Max. (AFTER TEST) DETECTION SWITCH CONTACT 100 mΩ Max. (INITIAL VALUE) 140 mΩ Max. (AFTER TEST)
4.1.2	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	DC 500 V の電圧を 1 分±5 秒間、隣接端子間に印加し、測定する。 APPLY A VOLTAGE OF DC 500 V FOR 60±5 s TO BETWEEN ADJACENT TERMINALS AND MEASURE.	1000 MΩ 以上 (初期) 100 MΩ 以上 (試験後) 1000 MΩ MIN (INITIAL VALUE) 100 MΩ MIN (AFTER TEST)
4.1.3	耐電圧 VOLTAGE PROOF	AC 500 V の電圧を 1 分間隣接端子間に印加する。 APPLY A VOLTAGE OF AC 500 V FOR 1 min TO BETWEEN ADJACENT TERMINALS.	絶縁破壊のないこと。 THERE MUST BE NO BREAKDOWN.
4.2 機械的特性 MECHANICAL CHARACTERISTICS			
4.2.1	カード挿入/挿出力 CARD INSERTION/ EJECT FORCE	プッシュプルゲージを用いて約 25 mm/min の速さで挿入、抜きを行う。 USING A PUSH-PULL GAGE, PERFORM INSERTION AND REMOVAL AT A SPEED OF APPROXIMATELY 25 mm/min.	初期 15 N 以下 INITIAL VALUE : 15 N MAX.
4.2.2	カード離脱力 CARD RELEASE FORCE		初期 0.5 N 以上 INITIAL VALUE : 0.5 N MIN. (カードロック状態から) (From the state of the Card Lock)
4.3	耐衝撃性 SHOCK	下記条件で試験を行い、試験値測定する。 CONNECTOR SHALL BE MEASURED AFTER FOLLOWING TEST. 1) 取付方法 正確の方法で取り付ける。 MOUNTING METHOD : NORMAL MOUNTING METHOD 2) 加速度 ACCELERATION : 490m/s ² 3) 作用時間 DURATION : 11 ms 4) 試験方向 6 面 TEST DIRECTION : 6 DIRECTIONS 5) 試験回数 各方向 3 回 (計 18 回) NUMBER OF SHOCKS : 3 TIMES PER DIRECTION (18 TIMES IN TOTAL)	試験中 0.1 μs を越える電流遮断がない事 THERE MUST BE NO CURRENT DISCONTINUITY OF MORE THAN 0.1 μs DURING THE TEST.
			
4.4	振動試験 VIBRATION TEST	MIL-STD-202 試験法 201A に準じて行う。(振動周波数 10~55 Hz) カード嵌合状態で、端子が直列回路になるように接続し、DC 1mA を通電しながら試験を行う。 PERFORM ACCORDING TO MIL-STD-202 TEST METHOD 201A. (VIBRATION FREQUENCY: 10~55 Hz) CONNECT THE TERMINALS TO MAKE A CIRCUIT IN SERIES WITH THE CARD INSERTED AND CONDUCT THE TEST WHILE CONDUCTING DC 1 mA (1) VIBRATION FREQUENCY RANGE 振動周波数範囲 : 10~55 Hz (2) TOTAL AMPLITUDE 全振幅 : 1.5mm (3) SWEEP RATIO 掃引の割合 : 10-55-10 Hz APPROX. 1min 約 1分 (4) METHOD OF CHANGING THE SWEEP VIBRATION FREQUENCY 掃引振動数の変化方法 : LOGARITHMIC OR LINEAR 対数又は直線近似 (5) DIRECTION OF VIBRATION : THREE PERPENDICULAR DIRECTIONS INCLUDING 振動の方向 ACTUATOR 操作部を含む垂直 3 方向 (6) DURATION 振動時間 : 2 H EACH (6H IN TOTAL) 各 2 時間 (計 6 時間)	試験中 0.1 μs を越える電流遮断がない事 THERE MUST BE NO CURRENT DISCONTINUITY OF MORE THAN 0.1 μs DURING THE TEST.

DOCUMENT No. SCDA-S-014	TITLE 製品仕様書 PRODUCT SPECIFICATION	PAGE 3/6
BACKGROUND SOKNIK-1604		
5. 信頼性 RELIABILITY		
項目 ITEM	試験条件 TEST CONDITIONS	判定基準 CRITERION
5.1 熱衝撃試験 HEAT SHOCK TEST	MIL-STD-202 の試験法 107B の試験条件 A に準じて行うものとし、3ヶ月前を -25℃ に 1 時間と 85℃ に 1 時間の順とし温度変化に 10 分加えらる。測定は最初の 1ヶ月前開始前と最終 1ヶ月前完了後、箱外に被試験品を取り出し 1~2 時間の間に行う。 IN ACCORDANCE WITH MIL-STD-202 TEST METHOD 107B, CONDITION A, PUT THE CONNECTOR THROUGH 5 CYCLES OF TEMPERATURE CHANGE, 1 CYCLE CONSISTING OF -25°C AND 85°C FOR EACH 1 HOUR. PERFORM MEASUREMENTS BEFORE THE FIRST CYCLE AND AFTER COMPLETION OF THE FINAL CYCLE, OUTSIDE THE TEST CHAMBER FOR BETWEEN ONE AND TWO HOURS.	接触抵抗 : 4.1.1 による 絶縁抵抗 : 4.1.2 による 試験中、物理的損傷の生じない事 CONTACT RESISTANCE : SEE 4.1.1 INSULATION RESISTANCE : SEE 4.1.2 NO PHYSICAL DAMAGE MUST OCCUR DURING THE TESTING.
5.2 高温保存試験 HIGH TEMPERATURE STORAGE TEST	MIL-STD-202 の試験法 108A の試験条件 B に準じて行うものとし、3ヶ月前を 85℃ の箱内に設置する。測定は試験開始前と 96 時間経過後、箱外に被試験品を取り出し 1~2 時間の間に行う。 IN ACCORDANCE WITH MIL-STD-202 TEST METHOD 108A, CONDITION B, LEAVE THE CONNECTOR IN A TEST CHAMBER AT 85°C FOR 250 HOURS. MEASURE THE SAMPLE BEFORE THE START OF THE TEST AND AFTER COMPLETION, OUTSIDE THE CHAMBER FOR BETWEEN ONE AND TWO HOURS.	接触抵抗 : 4.1.1 による 絶縁抵抗 : 4.1.2 による 試験中、物理的損傷の生じない事 CONTACT RESISTANCE : SEE 4.1.1 INSULATION RESISTANCE : SEE 4.1.2 NO PHYSICAL DAMAGE MUST OCCUR DURING THE TESTING.
5.3 低温保存試験 LOW TEMPERATURE STORAGE TEST	JIS G 0020 に準じて行うものとし、3ヶ月前を -25℃ の箱内に設置する。測定は試験開始前と 96 時間経過後、箱外に被試験品を取り出し、1~2 時間の間に行う。ただし、水滴は取り除く。 IN ACCORDANCE WITH JIS G 0020, LEAVE THE CONNECTOR IN A TEST CHAMBER AT -25°C FOR 96 HOURS. MEASURE THE SAMPLE BEFORE THE START OF THE TEST AND AFTER COMPLETION, OUTSIDE THE CHAMBER FOR BETWEEN ONE AND TWO HOURS. WATER DROPS SHALL BE REMOVED.	接触抵抗 : 4.1.1 による 絶縁抵抗 : 4.1.2 による 試験中、物理的損傷の生じない事 CONTACT RESISTANCE : SEE 4.1.1 INSULATION RESISTANCE : SEE 4.1.2 NO PHYSICAL DAMAGE MUST OCCUR DURING THE TESTING.
5.4 耐湿試験 HUMIDITY TEST	MIL-STD-202 の試験法 103B の試験条件 B に準じて行うものとし、3ヶ月前を 40℃、90~95% (RH) の箱内に 96 時間放置する。測定は試験開始前と、試験完了後箱内に被試験品を取り出し 1~2 時間の間に行う。ただし、水滴は取り除く。 IN ACCORDANCE WITH MIL-STD-202 TEST METHOD 103B, CONDITION B, LEAVE THE CONNECTOR IN A TEST CHAMBER AT 40 F/50°C AND 90~95% (RH) FOR 96 HOURS. MEASURE THE SAMPLE BEFORE THE START OF THE TEST AND AFTER COMPLETION, OUTSIDE THE CHAMBER FOR BETWEEN ONE AND TWO HOURS. WATER DROPS SHALL BE REMOVED.	接触抵抗 : 4.1.1 による 絶縁抵抗 : 4.1.2 による 試験中、物理的損傷の生じない事 CONTACT RESISTANCE : SEE 4.1.1 INSULATION RESISTANCE : SEE 4.1.2 NO PHYSICAL DAMAGE MUST OCCUR DURING THE TESTING.
5.5 挿抜試験 INSERTION AND REMOVAL TEST	EIA-364-A 7.1.1 相当において接触抵抗 (4.1.1 参照) → 10,000 回挿抜 → 接触抵抗 (4.1.1 参照) の順に測定を行う。挿抜スピードは 400~600 回/h で行う。AT A LEVEL EQUIVALENT TO EIA-364-A CLASS 1.1. MEASURE CONTACT RESISTANCE (SEE 4.1.1). PERFORM INSERTION AND REMOVAL 10,000 TIMES, AND MEASURE CONTACT RESISTANCE AGAIN. PERFORM INSERTION AND REMOVAL AT A RATE OF BETWEEN 400 AND 600 TIMES PER HOUR.	接触抵抗 : 4.1.1 による 絶縁抵抗 : 4.1.2 による 試験中、物理的損傷の生じない事 CONTACT RESISTANCE : SEE 4.1.1 INSULATION RESISTANCE : SEE 4.1.2 カードは 1,000 回毎に取りかえるものとする Change the card every 1,000 times.
5.6 H ₂ S 試験 H ₂ S GAS TEST	3ヶ月前を 40℃、約 80% (RH)、H ₂ S 3 ppm の箱内に 96 時間放置する。測定は試験開始前と試験完了後、箱外に被試験品を取り出し 1~2 時間の間に行う。 LEAVE A CONNECTOR IN A TEST CHAMBER AT 40°C, APPROXIMATELY 80% (RH) AND H ₂ S 3 ppm FOR 48 HOURS. MEASURE THE SAMPLE BEFORE THE START OF THE TEST AND AFTER COMPLETION, OUTSIDE THE CHAMBER FOR BETWEEN ONE AND TWO HOURS.	接触抵抗 : 4.1.1 による 絶縁抵抗 : 4.1.2 による CONTACT RESISTANCE : SEE 4.1.1 INSULATION RESISTANCE : SEE 4.1.2

DOCUMENT No. SCDA-S-014		TITLE 製品仕様書 PRODUCT SPECIFICATION	PAGE 4/6
BACKGROUND SOKNIK-1504			
6. 半田付け性 SOLDERABILITY			
	項目 ITEM	試験条件 TEST CONDITIONS	判定基準 CRITERION
6.1	半田付け性 SOLDERABILITY	半田付け端子部をフลักに浸し、 230 ± 5 °Cの半田に 3 ± 0.5 秒浸す。 DIP SOLDERED TERMINALS INTO FLUX AND MELTED SOLDER AS FOLLOWS. 半田浸漬時間 SOLDERING TIME : 3 ± 0.5 s 半田温度 SOLDER TEMPERATURE : 230 ± 5 °C	浸漬面積の95%以上は半田で覆われている事 (ただし切断面のぞく) 95% OF IMMERSED AREA MUST SHOW NO VOIDS, PIN HOLES. (Exclusion on cutting side)
6.2	半田耐熱性 RESISTANCE TO SOLDERING HEAT	THE TEST SHALL BE CONDUCTED UNDER THE FOLLOWING CONDITIONS. 下記条件で試験を行う。 RE-FLOW SOLDERING リフローはんたの場合 THE CONNECTER SHALL BE STORED IN A CHAMBER AT 150 ± 2 °C FOR 3 MIN. THEN THE CONNECTER SHALL BE KEPT IN A CHAMBER AT 230 ± 2 °C FOR 1 MIN. THE MEASUREMENT SHALL BE MADE AFTER GOING BACK TO NORMAL ROOM TEMPERATURE. 150 ± 2 °Cの高温槽に3分間放置後、 230 ± 2 °Cの高温槽に1分間放置し、 常温に戻ってから測定する。 MANUAL SOLDERING 手はんたの場合 WATTAGE OF SOLDERING IRON 　　　　　　　こて容量: 15 W DIAMETER OF SOLDERING IRON TIP 　　　　　こて先径: $\phi 1$ mm TEMPERATURE OF SOLDERING IRON TIP 　　　こて先温度: 350 ± 5 °C SOLDERING TIME 　　　　　　　　　　　　　はんた付け時間: 3 S MAX	接触抵抗: 4.1.1による CONTACT RESISTANCE : SEE 4.1.1

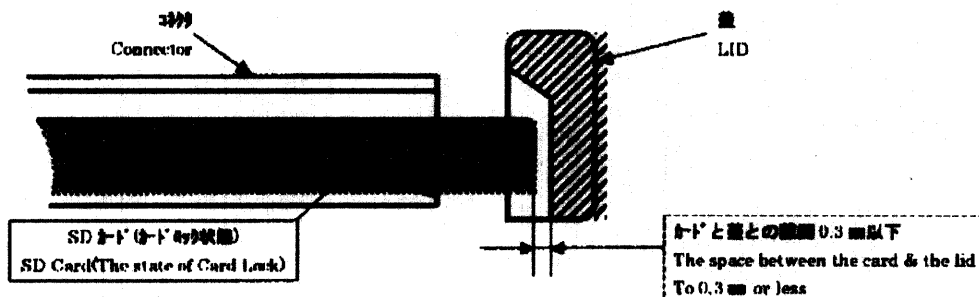
DOCUMENT No. SCDA-S-014	TITLE 製品仕様書 PRODUCT SPECIFICATION	PAGE 5/6
BACKGROUND SONNIK-1504		
<p>★ご使用上の注意 CAUTION IN USE</p> <p>1. コネクタの取り扱い上の注意 CONNECTOR HANDLING PRECAUTIONS</p> <p>(1) コネクタ上面からフラックスが侵入しないようにして下さい。 SAFEGUARD THE CONNECTOR ASSEMBLY AGAINST FLUX PENETRATION FROM ITS TOP SIDE.</p> <p>(2) 本製品は無洗浄を前提として設計しており、洗浄された場合、電氣的・機械的特性が悪化することがあります。 洗浄される場合は事前に連絡をお願いします。 THIS PRODUCT IS DESIGNED ON THE ASSUMPTION THAT THEY WILL NOT BE WASHED AFTER SOLDERING. IF YOU WASH IT, IT MAY BE CAUSE DETERIORATION OF MECHANICALLY AND ELECTRICALLY. IF WASHING IS NECESSARY, PLEASE MAKE CONTACT WITH US BEFOREHAND.</p> <p>2. タンシを半田付けされる場合、タンシに荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電氣的特性劣化のおそれがありますのでご注意ください。 WHEN SOLDERING TERMINALS, THERE IS A DANGER THAT LOAD PLACED ON THE TERMINALS MAY CAUSE RATTLE, DEFORMATION OR ELECTRICAL DEGRADATION TO OCCUR DEPENDING ON THE CONDITIONS. CAUTION IS THEREFORE REQUIRED.</p> <p>3. 半田付けの際、水溶性フラックスは製品を腐食させるおそれがありますので、ご使用はお避け下さい。 WHEN SOLDERING, DO NOT USE WATER SOLUBLE FLUX BECAUSE THIS MAY CORRODE THE PRODUCT.</p> <p>4. リフロー条件の設定については実際の量産条件で確認されるようお願いします。 REGARDING THE SETTING OF REFLOW CONDITIONS, PLEASE CONFIRM THEM WITH THE ACTUAL MASS PRODUCTION CONDITIONS.</p> <p>5. 基板のソリによって特性が悪化する場合がありますので、パターン設計、レイアウトについては十分考慮をお願いします。 AS P. W. B. WARPING MAY ALTER CHARACTERISTICS, PLEASE TAKE THIS INTO CONSIDERATION WHEN DESIGNING PATTERN AND LAYOUT.</p> <p>6. 本製品は、板厚 0.8 mm のプリント基板用に設計されております。 THIS PRODUCT IS DESIGNED TO BE FITTED TO A 0.8 mm THICKNESS P.C.B.</p> <p>7. プリント基板の取付け穴は、製品図に記載の指定寸法をご使用下さい。 THE DIMENSIONS OF HOLES FOR MOUNTING A P.C.B. SHALL CONFORM TO THE DIMENSIONS IN THE PRODUCT DRAWING.</p> <p>8. オンのON、OFF 切り替え動作時のバウンス及び、外部振動などのチャタリングによる誤動作防止の為下記のような配慮をお願いします。 Please attention following items to prevent connector from miss operation, such as bounding caused by on/off switching and Chattering by vibration</p> <ul style="list-style-type: none"> ・複数回の読みこみを行なう。 Repeated reading/writing. ・ディレイタイムを設定する。400msec 以上を推奨します。 Establish delay time-recommended 400msec Min. ・OR 積分回路を設定する。 Establish OR accumulation circuit. <p>9. 最大変位時コンタクト先端が基板に当たる事があります。 There is a thing that the contacting point touches the P.C.B. when maximum displacing.</p> <p>10. イジェクタ押し込み位置で半田付けを行なわないでください。 Please do not solder at the ejector pushing position.</p> <p>11. 本品に MMC を挿入すると MMC の PinNo7 パッドにコネクタの PinNo7、No8 のコンタクトがショートする可能性があります。 PinNo7 of the connector is in the PinNo7 pad of MMC when MMC is inserted in this item and there is a possibility that contacting of No8 is short.</p> <p>12. 当製品は、本来 AV、家電、事務機、通信機などの一般電子機器用に設計、製造したものです。したがって、高度の安全性および信頼性を必要とする医療、航空・宇宙機器、防衛機器などにご使用の際は、セットメーカー様において当該製品の適合性について十分なご確認をお願いします。 THIS PRODUCT HAVE BEEN DESIGNED AND MANUFACTURED FOR APPLICATIONS TO ORDINARY ELECTRONIC EQUIPMENT AND DEVICES SUCH AS THE AV EQUIPMENT ELECTRIC HOME APPLIANCES, OFFICE MACHINES AND COMMUNICATIONS EQUIPMENT. CONSEQUENTLY, WHEN EMPLOYING THESE PRODUCTS FOR APPLICATIONS REQUIRING A HIGH DEGREE OF SAFETY AND RELIABILITY SUCH AS THE MEDICAL EQUIPMENT, AVIATION AND AIRCRAFT EQUIPMENT, SPACE EQUIPMENT AND BURGLAR ALARM EQUIPMENT. THE USING MANUFACTURERS WILL PLEASE THOROUGHLY STUDY THE PROPRIETIES OF THESE PRODUCTS FOR THE PLANNED APPLICATIONS.</p> <p>13. 接点部、端子部の硫化及び酸化等による接触障害や、皮膜形成によるはんだ付け性の劣化等を防ぐ為に以下の点にご配慮下さい。 To prevent contact disturbance by the sulfuration or oxidation of the contact and terminal, and deterioration of solderability by thin film on the terminal, please note following:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高温高湿及び硫黄、塩素等の腐食性ガスの発生する恐れのある場所での保管、ならびに過剰な積み重ねはお避け下さい。 Storage in the atmosphere of high temperature, high humidity, corrosive gases such as sulfur or chlorinate gas, and excessive piling up of the carton boxes shall be avoided. ・コネクタは開梱せずに常温常湿で保管し、納入後3ヶ月以内を目安として、遅くとも6ヶ月以内でご使用下さい。 Connectors shall be stored as the package not opened and in the normal temperature and normal humidity, and the connectors shall be used preferably within 3 months, at least within 6 months. ・開梱後保管する際は、ポリ袋等で密封し直射日光の当たらない冷暗所に保管し、速やかにご使用下さい。 When the connectors are stored after opening the package, the connectors shall be sealed with a polyethylene bag etc. and stored in dark and cool place, avoiding direct sunlight. The connectors shall be used as soon as possible. 		

DOCUMENT No. SCDA-S-014	TITLE 製品仕様書 PRODUCT SPECIFICATION	PAGE 8/8
BACKGROUND SONNIK-1504		

14. カード抜け防止 Card omission prevention

本品にはカード抜け防止用の蓋が設けられていないため、カードを嵌合した状態で落下させたり熱衝撃試験を行ったりするとカードが抜けてきます。したがって、筐体にカード抜け防止用の蓋を設置してください。その際、カードロック状態でのカードと蓋の隙間は0.3mm以下にしてください。0.3mm以上の隙間があると、カード挿入時の接触が切れる場合があります。

Drops with the card locked because the lid for the card omission prevention is not installed in this connector or the thermal-shock test is done and the card comes off. Therefore, please set up the lid for the card omission prevention in the case. In that case, please adjust the space between the card and the lid in the state of the card lock to 0.3 mm or less. There is a case where the contact of the card insertion detection switch can be cut when there is a space of 0.3 mm or more.



【Example of re-flow soldering condition】(Reference) リフロー方式の参考例

1. Heating method: Double heating method with infrared heater
加熱方式 遠赤外線加熱による上下加熱方式とする。
2. Temperature measurement: Thermocouple φ0.1~0.2 CA(K) or CCT at soldering portion
温度測定方法 φ0.1~0.2のCA(K)またはCCTを用い測定。位置ははんだ接合部(銅箔面)とする。
3. Temperature profile
温度プロファイル

Temperature 温度(°C)

